





국가	기업명	중국측 합작선	주요 투자내용
일	세이코 업슨	上海 愛普生電子	ASIC을 중심으로 반도체 제품의 설계·연구개발, 판매
일	NEC	首鋼日電電子	- 8비트 MCU 생산 - 4MD램 일관공정, 16MD램 조립생산
일	후지쓰	雄越微電子有限公司	- 1-2 바이폴라 IC 미세기술 이전 - 가전제품 논리소자(5인치웨이퍼) 위탁생산
미	AT&T	華晶電子	- 선폭 0.9μ가공기술이전
미	모토로라	天津 공장건설	- 8인치 웨이퍼 연산 18만 개 생산능력(7억 2천만 달러 투자)
일	미쓰비시, 미쓰이	미쓰비시四通集成 電路公司	- ASIC, 마이컴 조립생산
일	히타치	히타치반도체有限公司	- 4MD램 조립생산, 前공정 확대계획
미	인텔	中國電子	- 386MPU 공동생산

2-5μm

가  
30% 2000  
10 10 30-40  
가 '20 '908  
'95 28 2 4 '90 가 '98 71 7 9 '93 15 1 2  
, 1~2 PC OA  
가 「三金工程」  
(3 Golden Project) 2000 20~30  
COCOM 가 가 COCOM

4

TV, VCR 1 1(紅燈), 2(黃燈), 3(錄燈)  
3

2  
高技術

'Made in China'

'Made in USA', 'Made in Japan', 'Made in Taiwan'

1)

